



京鼎精密科技股份有限公司

2025第三季法人說明會

2025/12/23

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

■ 公司簡介

李貞誼

發言人

鍾曉佩

副處長

■ 財務報告

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

徐朝煌

協理

黃俊凱

協理

鍾曉佩

副處長

■ 營運與展望

■ 問答交流

公司簡介



劉揚偉

董事長



邱耀銓

執行長

主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

全球佈局 區域製造



2001

成立

2015

上市(3413 TT)

3,978 員工人數

截至2025/11/28

NT\$ 10.85億 股本

截至2025/9/30

NT\$ 325.54億 市值

截至2025/11/28

2025年前三季營收

NT\$156.14億

+34.0% YoY

2025年前三季毛利率

25.6%

-0.7pps YoY

NT\$ 16.22元

-8.8% YoY

全球佈局

生產基地：橫跨 4 區 7 廠，羅勇廠 25Q1 啟用，春武里廠 26Q1 試產

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



上海松江廠



江蘇昆山廠



新產品開發中心

美國矽谷廠



美國加州/德州/亞利桑那州辦公室



BKK國際機場



春武里廠



林查班國際海港

羅勇廠



U-TAPAO國際機場
(2028啟用)

- : 營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇
- : 營運製造據點(新增)-泰國
- : 新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- : 銷售服務與國際採購據點-台灣/江蘇/加州/德州/亞利桑那州

財務報告



綜合損益表

| 單位：新台幣百萬元 | 3Q25 | | 2025 QoQ% | | | 3Q24 YoY% | | | YTD 3Q25 | | YTD 3Q24 YoY% | | |
|-----------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------------|---------|-----------|
| | 營業收入淨額 | 1,304 | 100.0% | 5,203 | 100.0% | 6.5% | 4,612 | 100.0% | 20.2% | 15,614 | 100.0% | 11,655 | 100.0% |
| 營業毛利 | 1,358 | 23.5% | 1,358 | 26.1% | -2.6 ppts | 1,234 | 26.8% | -3.3 ppts | 3,992 | 25.6% | 3,061 | 26.3% | -0.7 ppts |
| 營業費用 | (568) | (10.2%) | (481) | (9.2%) | | (424) | (9.1%) | | (1,502) | (9.6%) | (1,163) | (10.0%) | |
| 營業利益 | 736 | 13.3% | 877 | 16.9% | -3.6 ppts | 810 | 17.7% | -4.4 ppts | 2,490 | 16.0% | 1,898 | 16.3% | -0.3 ppts |
| 營業外損益 | 152 | 2.7% | (456) | (8.8%) | | (102) | (2.2%) | | (220) | (1.4%) | 302 | 2.6% | |
| 稅前淨利 | 888 | 16.0% | 421 | 8.1% | +7.9 ppts | 708 | 15.5% | +0.5 ppts | 2,270 | 14.6% | 2,200 | 18.9% | -4.3 ppts |
| 本期淨利 | 699 | 12.6% | 391 | 7.5% | +5.1 ppts | 582 | 12.6% | - | 1,813 | 11.6% | 1,824 | 15.6% | -4.0 ppts |
| 歸屬予： | | | | | | | | | | | | | |
| 母公司股東 | 667 | | 369 | | 81.0% | 582 | | 14.6% | 1,760 | | 1,824 | | -3.5% |
| 基本每股盈餘(元) | 6.10 | | 3.41 | | 2.69 | 5.52 | | 0.58 | 16.22 | | 17.79 | | (1.57) |
| 加權平均流通在外股數(百萬股) | 109.35 | | 108.17 | | | 105.42 | | | 108.48 | | 102.48 | | |

資產負債表及重要財務指標

單位：新台幣百萬元

| | 3Q25 | 2Q25 | 3Q24 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 現金及流動金融資產 | 6,600 25% | 7,543 29% | 9,613 45% |
| 應收帳款 | 2,113 8% | 1,815 7% | 1,703 8% |
| 存貨 | 4,151 16% | 3,904 15% | 3,449 16% |
| 長期投資 | 343 1% | 438 2% | 440 2% |
| 不動產、廠房及設備 | 9,287 35% | 8,016 31% | 5,012 24% |
| 無形資產 | 2,423 9% | 2,425 9% | 15 1% |
| 資產總計 | 26,732 100% | 26,062 100% | 21,506 100% |
| 應付帳款 | 1,669 6% | 1,359 5% | 1,533 7% |
| 銀行借款 | 3,264 12% | 2,829 11% | 1,782 8% |
| 應付公司債 | 95 0% | 222 1% | 586 3% |
| 流動負債 | 7,137 27% | 7,311 28% | 4,622 21% |
| 負債總計 | 9,493 36% | 10,077 39% | 7,333 34% |
| 股東權益總計 | 17,239 64% | 15,985 61% | 14,173 66% |
| 重要財務指標 | | | |
| 平均收現天數 | 33 | 32 | 29 |
| 平均銷貨天數 | 98 | 99 | 100 |
| 平均付現天數 | 40 | 38 | 39 |
| 淨營運現金週期天數 | 91 | 93 | 90 |
| 流動比率(倍) | 1.89 | 1.88 | 3.26 |

現金流量表



| 單位：新台幣百萬元 | YTD 3Q25 | YTD 3Q24 |
|------------|----------|----------|
| 期初現金 | 7,527 | 6,956 |
| 營運活動之現金流入 | 1,062 | 1,179 |
| 資本支出 | (2,618) | (1,451) |
| 現金股利 | (1,592) | (1,173) |
| 定期存款 | 747 | 720 |
| 銀行借款淨變動 | 1,326 | 111 |
| 企業合併現金淨支付數 | (1,263) | - |
| 投資與其他 | (71) | 319 |
| 期末現金 | 5,118 | 6,661 |
| 自由現金流量* | (1,556) | (272) |

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望



營收趨勢

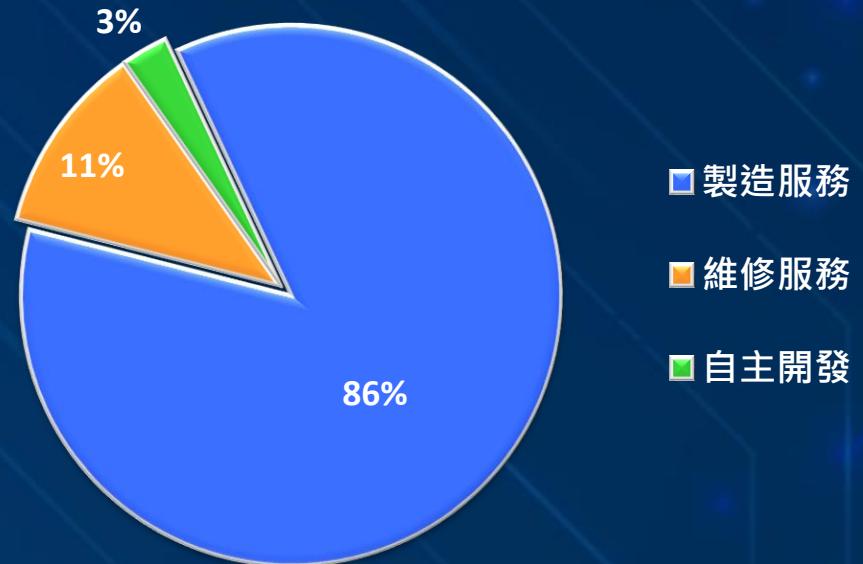


- Q3 营收 55.42 億元，YoY +20.2%、QoQ +6.5%，連六季成長、創單季新高
- 前三季營收 156.14 億元，YoY +34%，創同期新高



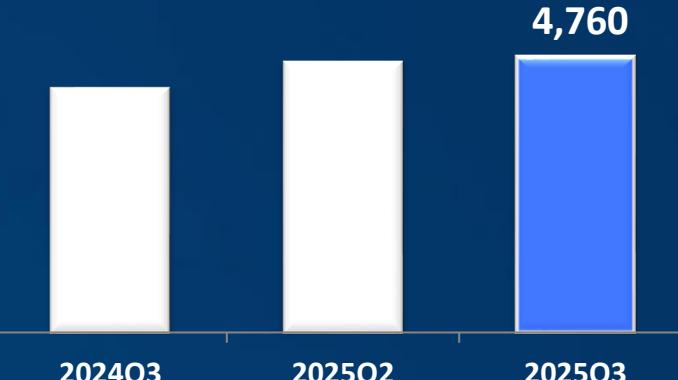
註：製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造
維修服務=半導體與航太維修
自主開發=半導體自動化設備

2025年第三季銷售分析-業務別



製造服務
+2.4% QoQ
+13.4% YoY

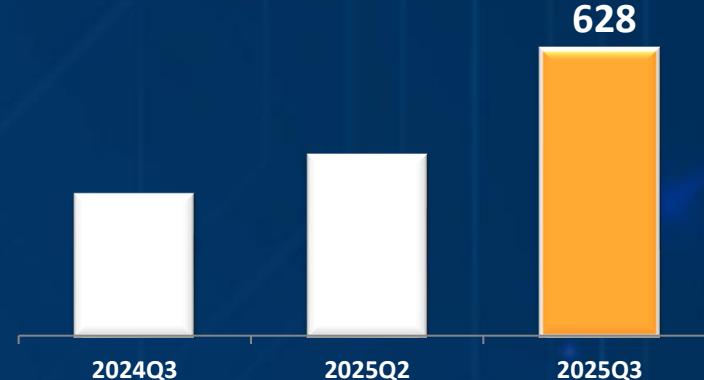
單位：台幣百萬



單位：台幣百萬

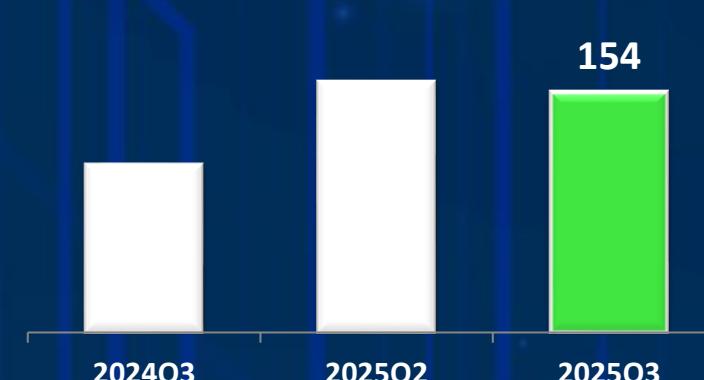
維修服務
+60.0% QoQ
+104.5% YoY

單位：台幣百萬



自主開發
-4.3% QoQ
+43.2% YoY

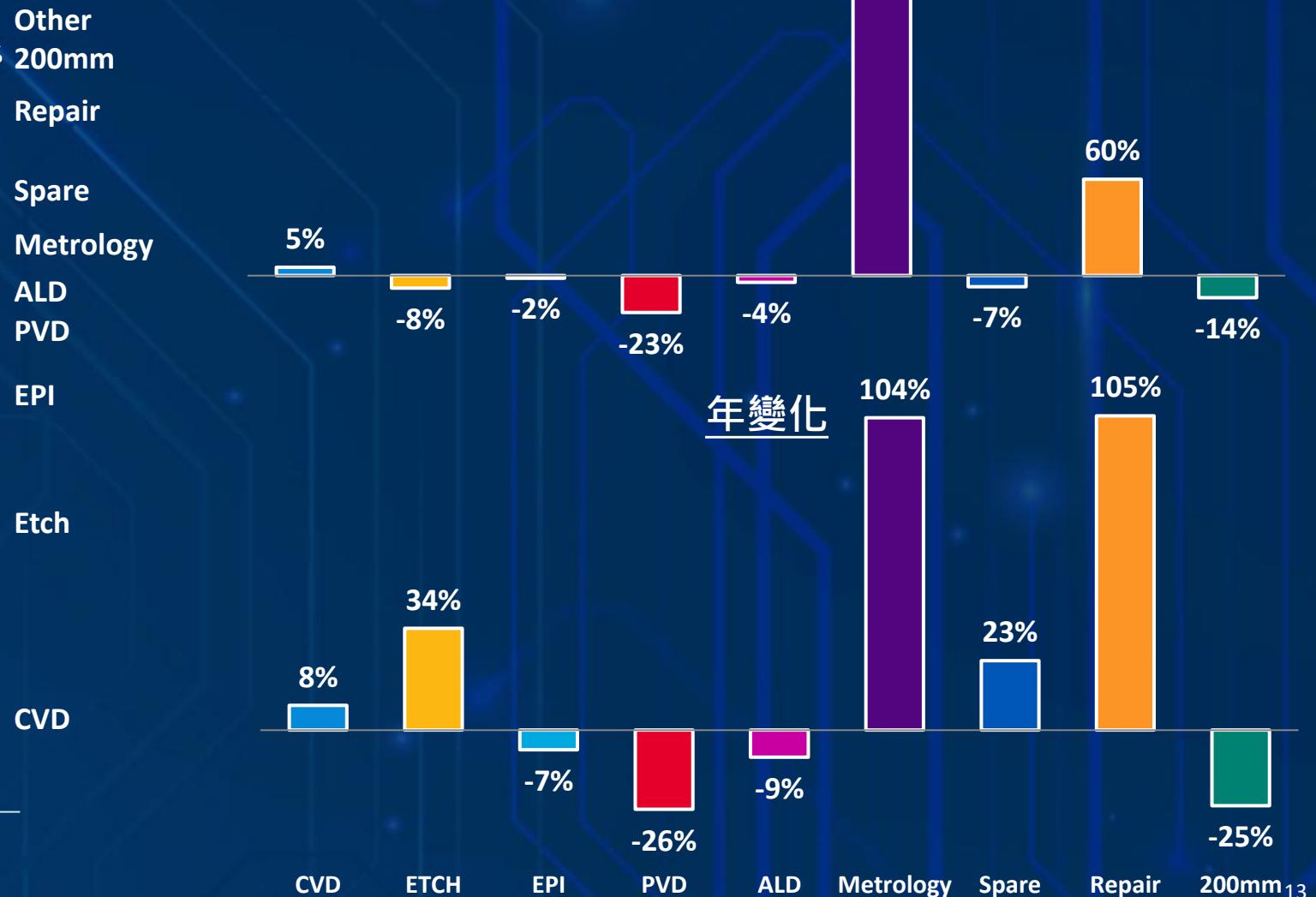
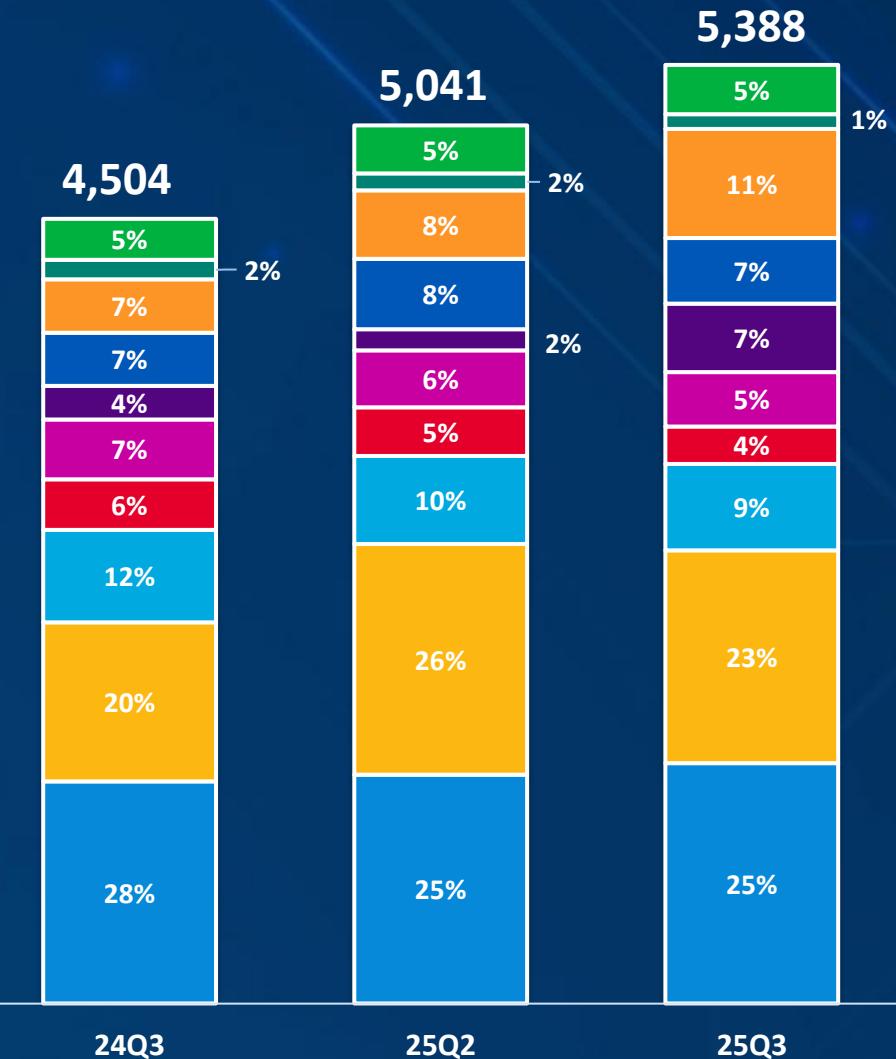
單位：台幣百萬



2025年第三季製造及維修服務銷售分析-產品別

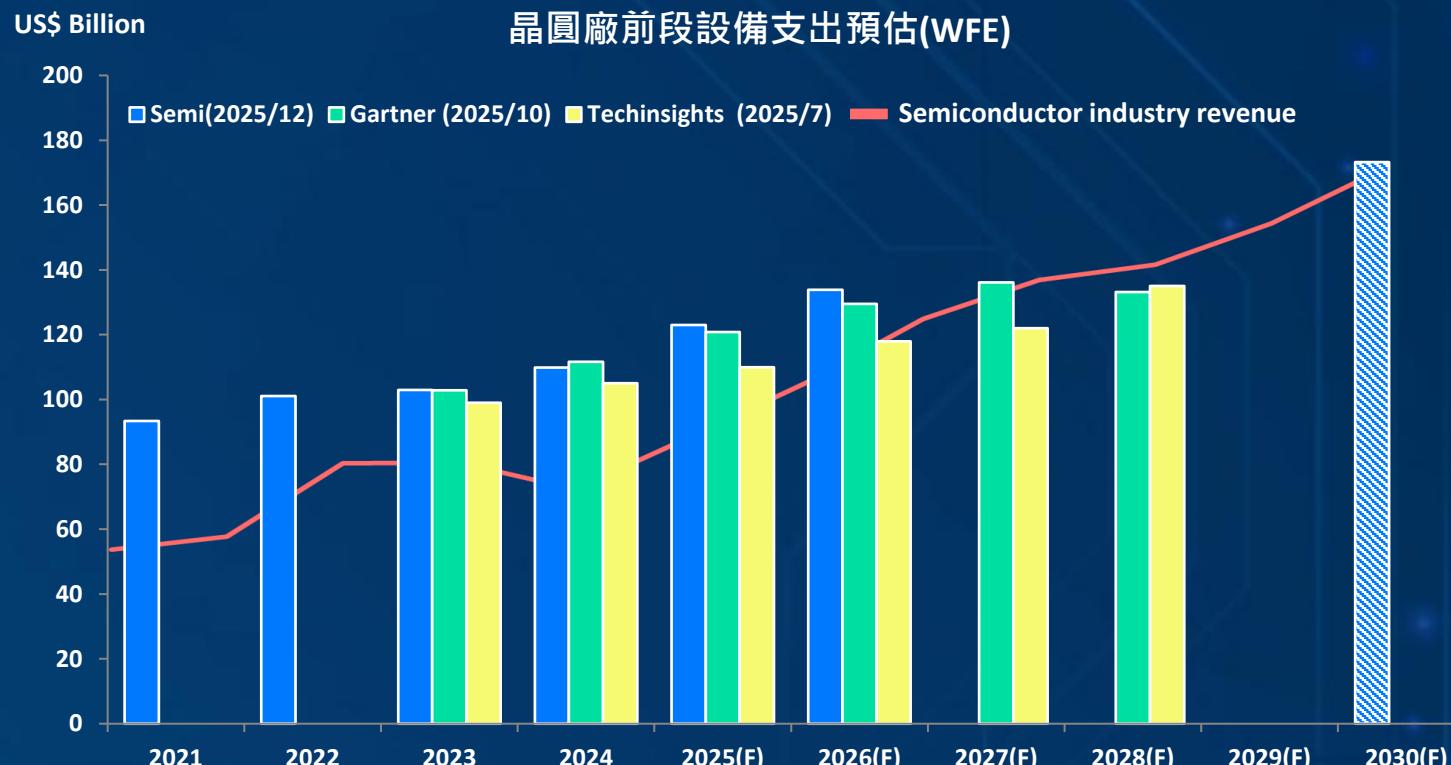


單位：台幣百萬



產業趨勢

- 2025 年 WFE 市場預期成長 5%–12%：AI 與 HPC 應用帶動先進製程需求強勁，惟中國市場放緩及消費性、工控與車用需求疲弱，抵銷部分成長動能。
- 2026 年 WFE 市場預估成長 7%–9%；受惠於先進製程升級（GAA、HBM）與先進封裝擴產，設備安裝時程集中於下半年，市場動能可望於 2026 年下半年轉強，並於 2027 年進一步放大。
- 長期展望：AI 應用擴大、先進製程持續升級，加上全球供應鏈區域化推進，帶動半導體設備需求進入結構性成長。



| WFE(\$B) | 2024 | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Semi (2025/12) | 110 | 123 | 134 | | |
| YoY | 7% | 12% | 9% | | |
| Gartner (2025/10) | 112 | 121 | 130 | 136 | 133 |
| YoY | 9% | 8% | 7% | 5% | -2% |
| TechInsights (2025/7) | 105 | 110 | 118 | 122 | 135 |
| YoY | 6% | 5% | 7% | 3% | 11% |

Source:Semi/Gartner/TechInsights

2025年第四季展望



獲獎榮耀



Onto Innovation
傑出供應商獎



TCSA
台灣企業永續報告書銀獎

春武里新廠正式啟用

春武里新廠於 11/11 正式啟用，2026 年第一季進入試產



■ 營運成果

- 第三季營收創單季新高，前三季累計亦創歷史同期新高；惟第二季匯兌損失影響前三季獲利。
- 春武里廠 11 月啟用，2026 年第一季試產，海外製造布局持續完善，強化公司全球供應鏈彈性。
- 客戶合作與永續治理表現，持續獲國際客戶與外部機構肯定。

■ 營運展望

- 2025Q4 至 2026 上半年的短期需求放緩，主要反映客戶提前備貨與晶圓廠設備安裝時程調整，客戶下單態度亦相對謹慎。
- 隨著先進製程與高階記憶體擴產於 2026 年下半年放量，設備投資動能可望回溫，帶動公司營收在下半年回升，2026 年營收表現維持穩健。
- 短期毛利承壓，在營收規模擴大與營運效率提升的情況下，有望支撐獲利表現。
- AI 與 HPC 應用擴大帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產；隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。

Q&A





Thank you

